

NEWSLETTER

VERMES Microdispensing 최신의 고성능 고수준 MDS 1560 Hot Melt Solution

VERMES Microdispensing은 전자 부품 개발 및 생산을 위한 세계 최고의 무역 박람회인 Productronica Munich에서 최신의 MDS 1560 Hot Melt 시스템을 소개하여 시장 입지를 더욱 강화했다.

이 시스템은 가장 완벽한 디스펜싱 결과를 위해 밸브 수율을 최적화하는 DST(Dynamic Shockwave Technology)에 의해 구동된다.

MDS 1560 Hot Melt 시리즈는 모든 유형의 핫 멜트 및 파라핀 접착제들을 초미세 액적 또는 선으로 디스펜싱하기 위한 최고의 솔루션이다.

최대 온도 섭씨 230도까지 가능한 VERMES Microdispensing의 새로운 MDS 1560 Hot Melt 솔루션은 산업 생산 라인의 특정 요구 사항을 충족할 수 있도록 가장 높은 용액 온도를 요하는 어플리케이션을 위해 설계되었다.

“시험과 검증이 완료된 DST - Dynamic Shockwave Technology와 핫 멜트시스템의 조합은 현재 시장의 요구에 부합하는 솔루션의 범위를 확장합니다. 그렇게 함으로써 우리는 고객의 요구를 예측하고 핫 멜트 디스펜싱 시장에서 선두에 설 수 있는 시스템을 제공할 수 있습니다.”라고 VERMES Microdispensing의 CEO Juergen Staedtler는 전했다.



- DST로 구동
- 모든 유형의 핫멜트 어플리케이션을 위한 완벽한 솔루션
- 핫글루 접착제 디스펜싱용 설계
- 전자제품 제조공정에 최적화
- 자유롭게 조정 가능한 파라메타 설정
- 복잡한 유형의 디스펜싱 옵션 제공
- 최장의 용액 안정성 보존

신속한 히팅과 가장 높고 안정적인 온도는 일관된 고주파수와 디스펜싱반복성을 유지하면서 정밀한 스트로크로 우수한 디스펜싱 환경을 보장한다.

새로운 MDS 1560 Hot Melt 솔루션은 셋업이 쉽고 초기 어드저스트나 추가 쿨링이 필요하지 않다.

이 시스템은 또한 디스펜싱 조건에 관계없이 정지, 시작 또는 슬로프와 같은 다양한 디스펜싱 지점에서 디스펜싱 파라미터를 수정할 수 있기 때문에 태핏 속도가 용액에 완벽하게 유지되는 동시에 압력의 변동도 방지한다.

카트리지와 노즐의 온도를 자유롭게 조절할 수 있어 사용하는 용액의 완벽한 점도 유지가 가능하다.

가동 시간과 비용은 생산 라인에서 중요한 요소이다. 변경하거나 교체되어야 하는 개별 구성 부품이 거의 없는 플루이드 박스 본체가 장착된 이 시스템은 공구사용 없이 빠른 조립과 분해가 가능하다. 또한 히팅된 경우에도 카트리지를 쉽고 빠르게 교체할 수 있어 사용자는 비용을 절감하고 운영을 간소화하며 생산성과 신뢰성을 높일 수 있다.

MDS 1560 Hot Melt 디스펜싱 시스템은 전자 산업, 예를 들어 전자 기기, 스마트폰 구성 요소 및 3D-MID 본딩 등을 포함한 광범위한 산업 응용 분야를 위한 완벽한 솔루션이다. 정확한 컷-오프와 디스펜싱은 비연속 접착 코팅 응용 분야에서도 선호되는 솔루션이다.

MDS 1560 Hot Melt 시리즈는 기존 VERMES Microdispensing의 소모품 및 다양한 태핏 및 노즐 인서트와 같은 부품과 완벽하게 호환되어 최대의 구성 유연성을 제공한다.

VERMES Microdispensing GmbH

Rudolf-Diesel-Ring 2
83607 Holzkirchen | Germany

+49 (0) 8024 6 44 0 | +49 (0) 8024 6 44 19



sales@vermes.com | www.vermes.com

Germany
+49 (0)8024 644 - 0
info@vermes.com

China
+86 (0)592 7257233
info@vermes.com

USA
+1 408 520-2555
america@vermes.com

Korea
+82 (0)32-246-1500
korea@vermes.com

Malaysia
+60 4 358 0996
info@vermes.com

